

中国国际金融股份有限公司

关于华润微电子有限公司

核心技术人员离职的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对华润微核心技术人员余楚荣先生离职的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、余楚荣先生离职的具体情况

公司核心技术人员余楚荣先生因退休返聘协议到期不再担任公司的任何职务。

余楚荣先生自2016年6月15日至2021年6月7日任公司董事，同时担任公司运营中心资深专务。

根据余楚荣先生退休返聘协议和保密及工作成果归属协议相关条款，余楚荣先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本核查意见披露日，余楚荣先生未直接或间接持有公司股份，未发现余楚荣先生退休返聘协议到期后前往竞争对手处工作的情形。

二、余楚荣先生离职对公司产生的影响

余楚荣先生离职不影响公司核心技术的完整性，不涉及公司核心技术研发的具体工作，目前不直接参与公司的在研项目，不会对公司现有研发项目进展产生影响。余楚荣先生已完成工作交接，余楚荣先生在公司任职期间未参与公司研发

的专利技术，余楚荣先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。

2018年、2019年、2020年及截至本核查意见披露日，公司研发人员数量为643人、653人、697人及791人，占员工总人数比例分别为8.08%、8.29%、7.70%及8.47%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为21人、20人、17人及16人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2018 年度	李虹、陈南翔、马卫清、余楚荣、王国平、苏巍、吴建忠、何波涌、丁东民、罗先才、方浩、计建新、刘红超、李勇强、邓小社、郑晨焱、吴泉清、张森、尤勇、夏长奉、李铁生
2019 年度	李虹、陈南翔、马卫清、余楚荣、王国平、苏巍、吴建忠、何波涌、丁东民、罗先才、方浩、计建新、刘红超、李勇强、邓小社、郑晨焱、吴泉清、张森、尤勇、夏长奉
2020 年度	李虹、马卫清、余楚荣、王国平、苏巍、吴建忠、丁东民、罗先才、方浩、计建新、刘红超、李勇强、郑晨焱、吴泉清、张森、尤勇、夏长奉
截至本核查意见披露日	李虹、马卫清、王国平、苏巍、吴建忠、丁东民、罗先才、方浩、计建新、刘红超、李勇强、郑晨焱、吴泉清、张森、尤勇、夏长奉

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因余楚荣先生离职产生重大不利变动，余楚荣先生离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

（一）保荐机构执行的核查程序

针对公司上述核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司与余楚荣先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议及退休返聘协议，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利

受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就余楚荣先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对余楚荣先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。余楚荣先生已与公司办理相关工作的交接，余楚荣先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；

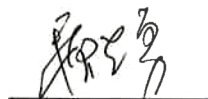
2、余楚荣先生已签署相关的退休返聘协议和保密及工作成果归属协议，余楚荣先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，余楚荣先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。


（全文结束）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



王 健

中国国际金融股份有限公司



2021年7月22日